

# 功率电子器件阻容二极管吸收电路元器件的选取

张保平

阻容二极管吸收电路是防止功率晶体管(BJT)、可关断晶闸管(GTO)等功率电子器件关断损坏的有效保护电路。本文通过分析,介绍正确选用功率电子器件阻容二极管吸收电路元器件的方法。

## 一、功率电子器件的关断损耗

GTO 常见的连接线路见图 5.1-1,其中  $I_L$  为 GTO 导通时流过负载的电流。当门极 G 施加瞬时负脉冲时,瞬时导通电流  $i_D$  由  $I_L$  值迅速下降为零,GTO 阳极与阴极间瞬时导通电压  $u$  由零值迅速上升到最大关断电压值  $V_{CD}$ (由电源电压  $V_{CC}$  和续流二极管 VD1 的正向导通电压降  $V_1$  决定)。GTO 关断后,由于电感 L 中电流经负载和 VD1 续流,忽略  $V_1$  可得  $V_{CD}=V_{CC}+V_1 \approx V_{CC}$ 。在关断过程中,GTO 功率电子器件内部瞬时功率有一最大耗散值,对功率电子器件的关断损坏有极大影响。其分析如下:

设  $i_D$  线性下降,  $u$  线性上升,即有

$$i_D = I_L(1 - t/t_f) \quad t \leq t_f$$
$$u = V_{CD} \cdot t/t_f \approx V_{CC} \cdot t/t_f$$

式中  $t_f$ —GTO 所需关断时间;

$t$ —0~ $t_f$  关断过程中任一瞬时时间值。

关断过程中电压、电流简化示意曲线见图 5.1-2。由  $i_D$  和  $u$  公式写出 GTO 关断过程的瞬

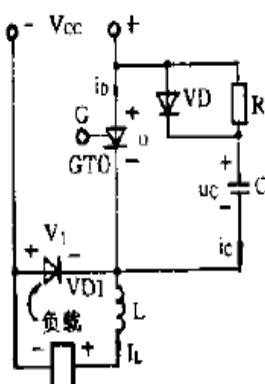


图 5.1-1

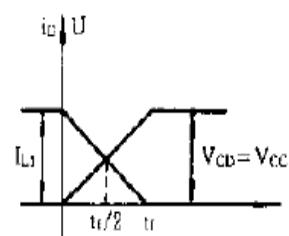


图 5.1-2

时功率表达式为

$$P = i_D \cdot u = I_L \cdot V_{CC}(1 - t/t_f) \cdot t/t_f$$

对 P 表达式求导数,并将  $t=t_f/2$  代入,得到关断过程的最大瞬时功耗为

$$P_m = 0.25 I_L \cdot V_{CC} \quad (1)$$

在  $t_f$  内,GTO 或 BJT 等功率电子器件内部的有效导通面积迅速减小,大量载流子汇集在

狭小的导通面积;若不对  $p_m$  采取限制措施,将极易出现功率电子器件的损坏。然而开通过程中,因器件内部有效导通面积迅速增大,一般不易出现瞬时过损耗。为分析方便起见,图 5.1-1 画出了图 5.1-1 电路中 GTO 门极电压  $u_G$  的一个开关周期 T 内的有关波形。

## 二、电容 C 和二极管 VD 吸收保护

GTO 两端并接的二极管 VD 和电容 C 在关断过程中导通,C 的充电电流  $i_C$  的分流,使 C 有效地吸收  $C \cdot V_{ac}^2/2$  的能量,减少了关断过程中 GTO 所吸收的能量,从而有效地保护了 GTO 的安全。

关断过程中,只要  $i_D$  未降到零,C 两端电压  $u_C$  经 VD 充电就迅速;只有当  $u_C = V_{cc}$  瞬间( $t = t_f$ ), $i_D$  下降为零,充电进入稳态(C 充电结束),VD1 导通续流。 $t_f$  时刻之前(见图 5.1-2)VD1 不续流,电感电流  $I_L$  保持常数,则

$$i_C = I_L - i_D = I_L \cdot t/t_f$$

$t_f$  时刻,C 充电到最大关断电压  $V_{cd} = V_{cc} + V_i \approx V_{cc}$ (忽略 VD1 的续流压降  $V_i$ )。将  $V_{cc}$  代入,得

$$u_C = V_{cc} = \frac{1}{C} \int_0^{t_f} i_C dt$$

解得

$$C = I_L \cdot t_f / 2V_{cc} \quad (2)$$

$i_C$  在一个周期内的平均值是 VD 的额定电流  $I_{DP}$ 。

$$I_{DP} = \frac{1}{T} \int_0^{t_f} i_C dt = 0.5 I_L \cdot t_f \cdot f \quad (3)$$

式中  $f = 1/T$  为  $u_G$  的频率(即为 GTO 工作频率)。

C 充电和关断过程中的各电压电流波形见图 5.1-3。

例 1: 取  $V_{cc} = 100$  V,  $I_L = 10$  A,  $t_f = 2 \mu s$ ,  $f = 1$  kHz(目前,GTO 的开关频率低于 3 kHz)。由式(2)、(3)可得

$$C = 10 \times 2 \times 10^{-6} / 2 \times 100 = 0.1 \mu F$$

$$I_{DP} = 0.5 \times 10 \times 2 \times 10^{-6} \times 10^3 = 0.01 A$$

C 一般选取无感电容,且连接导线到 GTO 或 BJT 等功率电子器件的距离应尽量缩短,以减小导线的电感。VD 最好选用软恢复特性的高频整流二极管,不要选用硬恢复特性的开关管。因为硬开通性能的开关二极管极易激发电路的高频自激振荡,过大的  $di/dt$  变化又引起大的  $du/dt$ ,导致被保护管的损坏。

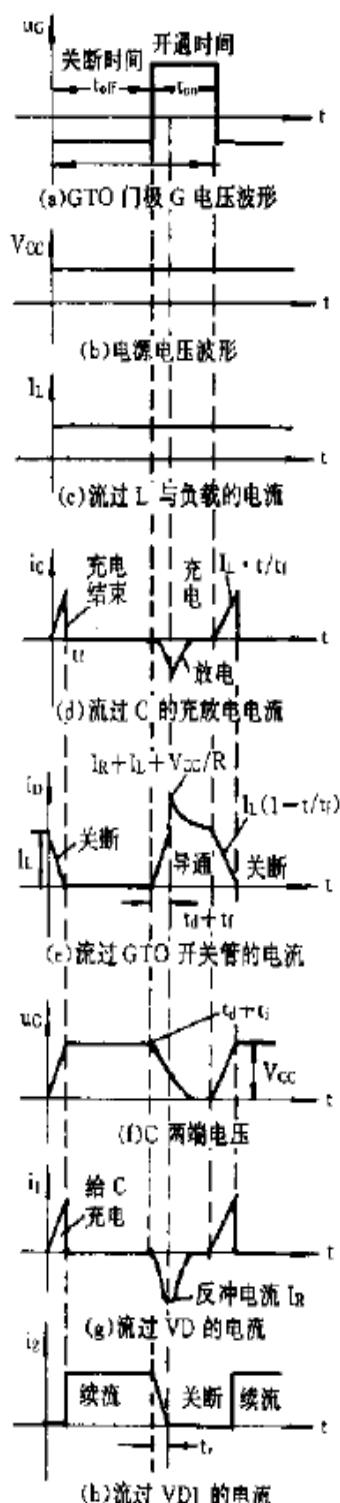


图 5.1-3

### 三、RC 放电分析及器件选择

功率电子器件控制极施加  $t_{on}$ (正脉冲)时,GTO 的  $i_D$  在上升时间  $t_r$  内由零增至  $I_L$  值。另外,还有  $i_C = V_{CC}/R$  的放电电流峰值和  $VD$  的反冲关断电流也要流入刚才导通的 GTO(见图 5.1-3)。必须对上述电流加以限制,以防止开通电流超限,即应满足:

$$I_L + i_{cm} + I_R < I_M$$

式中  $I_R$ — $VD$  的反冲关断电流;

$I_M$ —GTO 或 BJT 允许的额定电流;

$i_{cm}$ —C 放电电流峰值。

将  $i_{cm} = V_{CC}/R$  代入得到 R 的下限

$$R > V_{CC}/(I_M - I_L - I_R) \quad (4)$$

$I_R$  一般可按经验选为  $0.2 I_L$ 。

RC 时间常数的选取决定 R 的上限,一般应保证  $t_{on}$ (导通时间) $-t_d$ (导通电流延迟时间) $-t_r$ (导通电流上升时间)时间内 C 放电完毕。之所以减去  $t_d$  和  $t_r$ ,是因正脉冲加到 GTO 控制极时,经  $t_d+t_r$  时间,GTO 才能充分导通;在  $t_d$  和  $t_r$  内,C 不能有效放电。 $t_{on}$  取最小导通时间  $t_{onmin}$  时应满足下式:

$$4RC < (t_{onmin} - t_d - t_r)$$

解 R 上限

$$R < (t_{onmin} - t_d - t_r)/4C \quad (5)$$

综合式(4)和(5)得

$$V_{CC}/(I_M - I_L - I_R) < R < (t_{onmin} - t_d - t_r)/4C \quad (6)$$

读者应注意:此处的  $t_{on}$  是 GTO 控制极的正脉冲宽度,而不是手册中的开启时间  $t_{on} = (t_d + t_r)$ ;两者符号在许多资料中相同,应注意区别。通常  $t_{onmin}/T < 1/2$  占空比时,经 GTO 传输到负载的电源功率,比占空比  $t_{onmin}/T > 1/2$  时减小,功率晶闸管不易出现过热损坏;故可人为限定  $t_{onmin}$  为小于  $T/2$  的取值,这样,C 放电在 GTO 吸收较小功率的时间内进行。当  $t_{on} > t_{onmin}$  时(吸收功率增大),C 已放电完毕(C 放电和开通过程的各电压电流波形见图 5.1-3)。

例 2:  $V_{CC} = 100$  V,  $t_d + t_r = 2 \mu s$ ,  $t_{onmin} = 15 \mu s$ ,  $I_M = 20$  A,  $I_L = 10$  A,  $C = 0.1 \mu F$ 。计算时取  $I_R = 0.2 I_L = 2$  A,  $I_L$  在所有计算公式中均取最大占空比时的负载电流。由式(6)可得

$$100/(20 - 10 - 2) < R < (15 \times 10^{-6} - 2 \times 10^{-6})/(4 \times 0.1 \times 10^{-6})$$

即  $12.5(\Omega) < R < 32.5(\Omega)$

对 BJT,取 R 为  $20 \Omega$  较大值可限制放电电流峰值  $i_{cm} = V_{CC}/R$ ;对 GTO,取  $R = 15 \Omega$  较小值更有利使 GTO 的导通电流达到大于掣住电流的取值。R 经常使用大功率实心电阻器,R 的功耗  $P_R$  是 C 吸收储能值与开关调期(工作频率 f)的比值。

$$P_R = 0.5C \cdot V_{CC}^2/T = 0.5C \cdot V_{CC}^2 \cdot f \quad (7)$$

取前面例 1 算得的  $C = 0.1 \mu F$ ,并将  $f = 1$  kHz,  $V_{CC} = 100$  V 代入式(7)得

$$P_R = 0.5 \times 0.1 \times 10^{-6} \times 100^2 \times 10^3 = 0.5 \text{ W}$$

由式(7)知,阻容二极管吸收保护是纯耗能保护,C 与 f 都不宜取太大值。尤其是 C 不能取太大,f 增大有利于减小电感 L,有时可适当取大些。

#### 四、阻容二极管器件选择计算实例

常用的脉宽调制(PWM)控制直流电机调速系统原理电路见图 5.1-4。

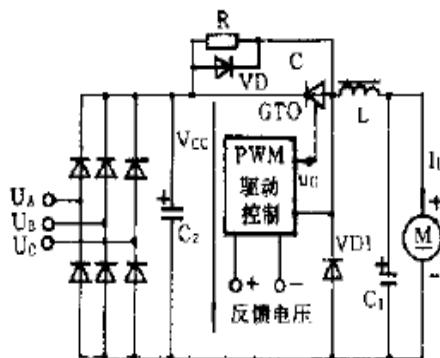


图 5.1-4

(1) 电源电压  $V_{CC}$  由三相交流电压经桥式整流滤波在电容  $C_2$  两端得到, 其值:

$$V_{CC} = 2.34 U_p$$

式中:  $U_p = U_A = U_B = U_C$  为三相交流相电压有效值。

此例取  $U_A = U_B = U_C = U_p = 110$  V, 得

$$V_{CC} = 2.34 \times 110 = 257$$
 V

(2) 负载电流  $I_L$ : 由直流电动机负载的额定电流确定。

设电机型号为 Z2-52(它励), 额定电流由电工手册或电机铭牌标志可知(额定电压 230 V, 额定功率 6 kW)  $I_L = 26.1$  A。

(3) GTO 关断时间  $t_f$ : 由功率半导体器件手册查知为 10  $\mu$ s(国产 50 A 的 GTO)。

(4) GTO 门极控制电压  $U_G$  的频率  $f$ : 由 PWM 驱动控制器的内部电路在调试时确定, 使用时都给出确定值。GTO 和 BJT 器件可取 1~2 kHz, 此处取 1 kHz。

(5) 将  $V_{CC}=257$  V,  $I_L=26.1$  A,  $t_f=10 \mu$ s,  $f=1$  kHz 分别代入式(2)和式(3), 吸收电容

$$C = 26.1 \times 10 \times 10^{-6} / (2 \times 257) = 0.5 \mu F$$

$$I_{DR} = 0.5 \times 26.1 \times 10 \times 10^{-6} \times 10^3 = 130.5$$
 mA

(6) GTO 允许电流  $I_M$  和  $t_d+t_r$ : 本例选国产 50A 的 GTO 器件时, 由功率半导体器件手册查知  $I_M=50$  A,  $(t_d+t_r)=6 \mu$ s。

(7) 将  $V_{CC}=257$  V,  $I_L=26.1$  A,  $I_R=0.2I_L=5.22$  A,  $I_M=50$  A 代入式(4)得  $R$  下限值为

$$R > 257 / (50 - 26.1 - 5.22) = 14 \Omega$$

(8) 将  $t_{on,min}=T/2=1/2f=0.0005$  s,  $(t_d+t_r)=6 \mu$ s,  $C=0.5 \mu F$  代入式(5)得

$$R < (500 \times 10^{-6} - 6 \times 10^{-6}) / (4 \times 0.5 \times 10^{-6}) = 248 \Omega$$

(9) 将  $C=0.5 \mu F$ ,  $V_{CC}=257$  V,  $f=1$  kHz, 代入式(7)得  $R$  消耗功率

$$P_R = 0.5 \times 0.5 \times 10^{-6} \times 257^2 \times 10^3 = 16.5$$
 W

综合式(7)、式(8)、式(9)可选择  $R=100 \Omega$  阻值, 并用两个大瓦数 200  $\Omega$  电阻并联实现。

$C$  与二极管 VD 的耐压均取 1.5  $V_{CC}=386$  V 以上的器件, 考虑电源电压的波动, 取 500 V 耐压的器件即可。